

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成 17 年 12 月 22 日 (2005.12.22)

【公表番号】特表 2004-532299(P2004-532299A)

【公表日】平成 16 年 10 月 21 日 (2004.10.21)

【年通号数】公開・登録公報 2004-041

【出願番号】特願 2002-571782(P2002-571782)

【国際特許分類第 7 版】

C 0 9 J 163/00

C 0 9 J 5/00

C 0 9 J 11/06

C 0 9 J 163/02

【F I】

C 0 9 J 163/00

C 0 9 J 5/00

C 0 9 J 11/06

C 0 9 J 163/02

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 2 月 2 日 (2005.2.2)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

シリコン、貴金属、プラスチック、ポリイミドまたはその組み合わせを含む基材を接着するのに有用な硬化性接着剤組成物であって、

エポキシ樹脂と、触媒または硬化剤と、チオエーテルジエポキシドとの混合物を含む、組成物。

【請求項 2】

シリコン、貴金属、プラスチック、ポリイミドまたはその組み合わせを含む基材と、請求項 1 に記載の接着剤組成物の反応生成物を含む接着剤とを含む、製品。

【請求項 3】

基材と請求項 1 に記載の接着剤組成物とを接触させるステップと、

該接着剤組成物を硬化するステップとを含む基材の接着方法であって、

前記基材が、シリコン、貴金属、プラスチック、ポリイミドまたはその組み合わせを含む、方法。